

2024년 AI반도체 기업 해외진출지원 결과보고

- 한·베트남 디지털포럼 전시 -

(‘24.12.02.(월), AI인프라본부 AI반도체팀)

□ 추진배경

- 전 산업 AI확산과 혁신적인 AI서비스 제공을 위한 핵심 인프라로 저전력·고성능의 AI반도체 중요도 급부상, 거대한 글로벌 시장 형성
 - * 시스템반도체의 차세대 성장동력인 AI반도체 시장규모는 2022년 411억 달러에서 2028년 1,330억 달러로 연평균 21.6% 성장할 전망
- 이에, 우리 AI반도체 기업의 글로벌 경쟁력 강화와 시장 확장을 위해, 초기 단계의 국내 팹리스 기업 해외 진출 지원 필요
 - 우리나라와 베트남 양국의 ICT/디지털전환 분야 공동 협력 행사인 ‘한-베트남 디지털전환 포럼’ 행사에 우리 AI반도체 기업 참가지원

2024년 한-베트남 디지털포럼 행사 개요

- 행사명 : 2024년 한-베트남 디지털 포럼
- 일시/장소 : 2024.11.21.(목) - 11.22(금) / 베트남 하노이
- 주최 : 한국 과기정통부, 베트남 정보통신부 공동 주최
- 참가규모 : 베트남 정부기관, 한국·베트남 IT기업 50개사, 300명
 - ※ [베트남] 정통부(축사), 국가혁신센터, 지방성장, 하노이 인문대학장/의대학장
 - [한국] NIPA원장(개회사), 주베트남 한국대사(축사), 가상융합경제포럼의장 등
- 연계행사 : 한-베트남 기업 네트워킹 행사, IR피칭, MOU 체결식 등

□ 출장목적

- 국내 AI반도체기업의 베트남 현지 행사 참가를 통한 국산 AI반도체 제품 및 기업에 대한 해외 시장 수요 발굴 및 제품 판로 확대 지원
 - (국제행사 전시상담회 지원) ‘한-베 디지털 포럼’ 연계 AI반도체 기업 전시부스 운영 및 비즈니스 상담회 운영 지원
 - * 전시부스 사전점검, 전시 부스 운영, 바이어 매칭 등 우리 기업 전시 참가

- (협력 네트워킹 확보) AI서비스, AI인프라 및 AI반도체 수요 정보
및 현지 주요 기관 및 기업 협력 네트워크 확보

* 하노이IT지원센터와 협력으로 현지 협력 기관 발굴 및 협력

- 출장일정 : '24. 11. 20.(수) ~ 11. 23.(토) (3박 4일)
- 출장지 : 베트남(하노이)
- 출장자 역할분담

일 정	주요업무
정재학 팀장	<ul style="list-style-type: none"> ○ AI반도체 기업 행사 참가 지원 총괄 ○ '한-베 DX 포럼' 전시 부스 사전 점검 및 전시 지원 ○ 베트남 수요처 발굴 및 우리 기업 네트워킹 지원 ○ 시장조사, 베트남 지역 협단체 등 AI반도체 현지 진출 지원을 위한 협력 네트워크 확보
임소현 선임	<ul style="list-style-type: none"> ○ '한-베 DX 포럼' 전시 부스 운영 지원 ○ '한-베 DX 포럼' 현지 수요 기업, 기관 비즈니스 상담회 운영 ○ '한-베 DX 포럼' 전사상담회 성과 관리 ○ 한-베 네트워킹 행사, 기업간담회 등

□ 전시회 및 부스 안내

- 전체 행사 일정

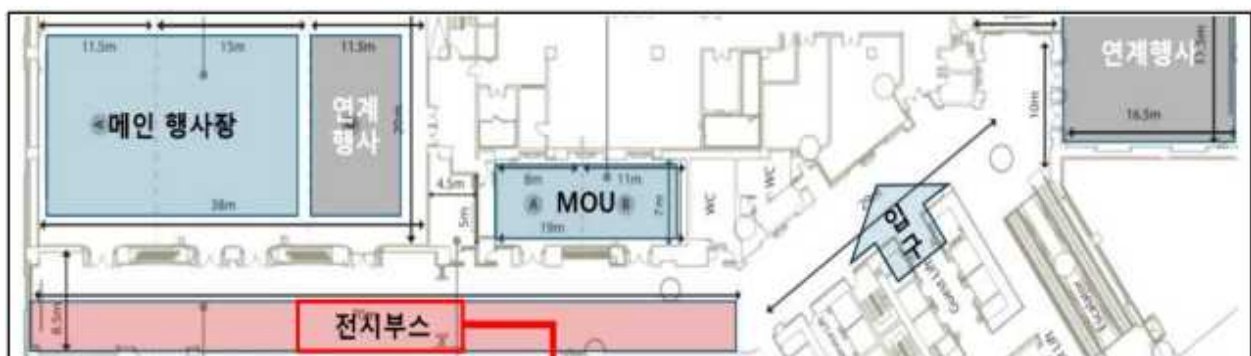
구분		크리스탈 A/B룸	크리스탈 C룸	로비 공간	에메랄드룸
11.21(목) [1일차]	오전	[개막식 및 기조연설]	[비즈매칭] 한-베트남 XR기업교류회	[제품전시] 전시부스 운영 - 디지털부스 - AI반도체 - 메타버스 등	[비즈매칭] ICT비즈니스 파트너십
	오후	[컨퍼런스] DX현황·사례 발표			
	저녁	스타트업 VIP 네트워킹 행사(하노이 롯데호텔 63층(우리금융 디노랩 후원))			
11.22(금) [2일차]	오전	[컨퍼런스] 베트남 IT현황 소개	한-베 스타트업 IR피칭	[제품전시] 전시부스 운영 - 디지털부스 - AI반도체 - 메타버스 등	[비즈매칭] ICT비즈니스 파트너십
	오후	[컨퍼런스] 한국 IT동향 소개			

○ 세부 일정 및 행사장 레이아웃

일시	주요내용	비고
11.21(목)	09:00-11:30	한-베트남 IT 스타트업 피칭
	11:30-13:00	Lunch
	13:00-13:15	개막식
	13:15-14:05	기조연설 : AI from Korea
	14:05-14:25	Coffee Break
	14:25-15:40	기조연설 : AI in Korea
	15:40-16:00	Coffee Break
	16:00-16:40	발표 - 공공 분야
	16:40-17:40	발표 - 데이터 및 클라우드 서비스
	18:30-20:30	베트남 VIP 초청 네트워킹
11.22(금)	10:00-11:40	발표 - 디지털 헬스
	12:00-13:00	Lunch
	13:00-15:00	발표 - 학습 & 훈련
	15:00-15:20	Coffee Break
	15:20-16:00	발표 - AI반도체 - World's Leading High Performance AI Chips for On-Device & On-Premise AI(김성모, 모빌리티 상무) - AI Semiconductor for LLM(정용웅, 하이퍼엑셀 CSO)
	16:00-17:40	발표 - 제조 & 산업

○ 자리배치도 (전시 부스 위치)

- 롯데호텔 하노이 6F 이벤트홀 전체



< 2024 한-베트남 디지털포럼 개요 >

○ 행사명 : 2024 한-베트남 디지털포럼(Vietnam-Korea Digital Forum)

※ 베트남 정통부 제안(디지털포럼을 양국에서 교차 개최) 반영, '24년부터 행사 명을 '디지털 포럼'으로 변경(금년은 베트남이 8.2 서울에서 먼저 개최)

○ 목적 : 한-베트남 정부·기업 간 협력 증진 및 교류 확대

○ 기간 : 2024. 11. 21.(목) ~ 11. 22.(금)

※ 베트남 정통부 주관 국제디지털주간(VIDW, 11.19.~11.22./하롱시) 연계

○ 장소 : 하노이 롯데호텔 6F 및 롯데센터 65F 라운지 등

○ 주최/주관 : 과학기술정보통신부(※ 베트남 정통부 공동) / NIPA

※ 후원 : 우리금융 디노랩, 주베트남 한국대사관, 주베트남 IT기업협의회 등

○ 참가규모 : 베트남 정부·기관, 한국·베트남 IT기업 50개사, 300여명

※ [베트남] 정통부(축사), 국가혁신센터, 국립하노이 의대 총장, 하노이대 총장, 베트남 IT·SW협회장 [한국] NIPA원장(개회사), 주베트남 한국대사(축사) 등

○ 행사구성

① 주요행사 : 개막식, 기조연설·우수사례 발표, 한국 IT서비스 전시

- (컨퍼런스) 기조연설 및 한-베트남 DX현황·사례 발표 등
- (제품전시) 현지수요가 높은 한국 IT 서비스 전시부스 운영(17개)

※ 디지털헬스(AI융합), AI반도체(AI인프라), XR·디지털콘텐츠(메타버스) 등

② 부대행사 : 스타트업 피칭, 베트남 VIP 초청 네트워킹, MOU체결식

- (IR 피칭) 정부/기관/대기업 대상 IR 피칭(※ 우리금융 디노랩 후원)
- (VIP 네트워킹) 베트남 정부·기관·기업 고위급 초청행사(양국 50명씩)
- (MOU 체결식) 한-베트남 기관·대학·기업 간 MOU 체결식장 운영

③ 연계행사 : 우리원 사업부서별 자체사업 및 민간협력 행사 연계

- (비즈매칭) 한-베트남 XR기업교류회, ICT비즈니스 파트너십
- (민간협력) 가상융합경제포럼

□ 2024년 한-베 디지털포럼 전시 결과

가. 한-베 디지털포럼 참가기업(4개사)

순위	분야	기업명	전시내용
1	AI반도체	넥스트칩	Vision & ADAS Processor
2	AI반도체	딥엑스	AI CHips, NPU 'DX-GEN1'
3	AI반도체	모빌린트	On-Device & On-Premise AI Chips
4	AI반도체	하이퍼엑셀	AI Semiconductor for LLM

○ 참가기업 개요

1) 넥스트칩(Nextchip)

- 1997년 설립된 비전 프로세서 전문 팹리스 기업
- 주요 제품 : ADAS 및 Vision Processor (예: NVP2431C, NVP6181B)
- 스마트카, 자율주행, 보안 카메라 등 다양한 영상 기반 솔루션 제공

2) 딥엑스(DeepX)

- 2018년 설립된 차세대 AI NPU(Near Processing Unit) 개발 전문 기업
- 주요 제품: NPU 'DX-GEN1', 초저전력 AI 연산 프로세서
- 스마트팩토리, 헬스케어, IoT 기기 등 엣지 AI 분야에서 기술 확장

3) 모빌린트(Mobilint)

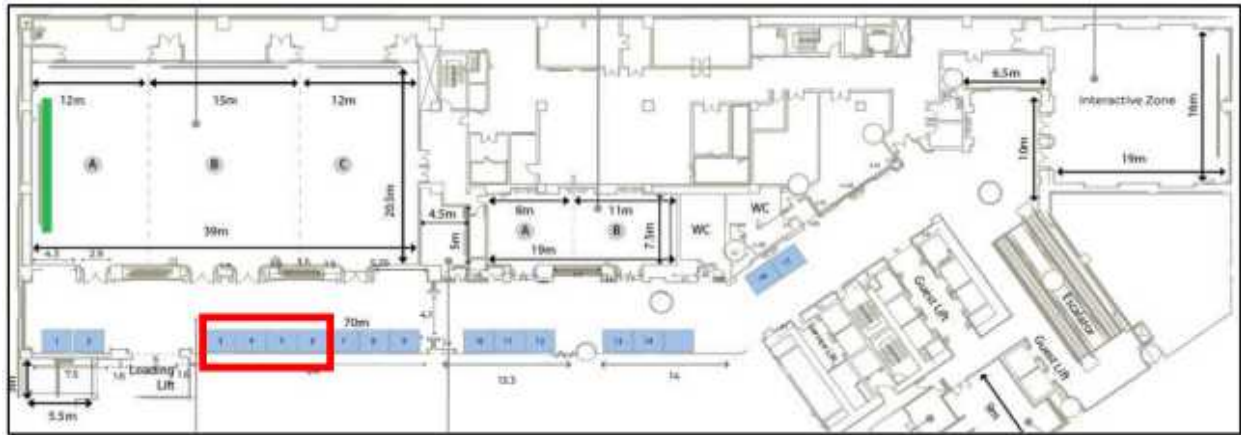
- 2020년 설립된 AI 반도체 및 온디바이스(On-Device) AI 솔루션 기업
- 주요 제품: 고성능 AI 칩셋 (예: Mobilint AI-Chip Series)
- 제조업, 헬스케어, 공공 분야에서 AI 반도체 기술 적용

4) 하이퍼엑셀(HyperAccel)

- 2021년 설립된 대규모 언어 모델(LLM) 및 AI 반도체 전문 기업
- 주요 제품: LLM 지원 AI 반도체 플랫폼 및 클라우드 최적화 솔루션
- 데이터센터, 클라우드 서비스, AI 학습 및 추론 솔루션에 활용

나. 참가기업 지원사항

① 전시부스 설치 및 운영 지원



○ 부스 구성(3m x 2.3m, 의자 4 / 테이블 1, TV, 입식배너 등) 및 배치

* AI반도체 기업 부스에는 추가로 180cm 책상 제공 예정

부스 이미지	정면

② 비즈니스 네트워킹 지원

○ 바이어 발굴 및 섭외 일정

일자	내용
11.04(월)	1차 바이어리스트 송부
11.06(수)	1차 바이어리스트 피드백
11.14(목)	최종 바이어 리스트 & 매칭테이블 송부
11.20(수)	바이어리스트 보강(필요시)

○ 참가 바이어 목록

	베트남 바이어사	담당자 명	담당자 직급
1	MES HI-TECH COMPANY LIMITED	Mr. Nguyen Trung Hieu	Sales Manager
2	BKAV CORPORATION	Mr. Dang Ngoc Giap	Sales Director
3	STI-VIETNAM	Mr. Pham Ba Thanh	Sales Engineer
4	VNROBOTICS	Mr. Nguyen Thanh Hai	Sales Manager
5	CMC ATI	1. Mr. Dang Minh Tuan 2. Mr. Tran Xuan Duc	1. Director 2. Development Projects Manager
6	PHENIKAA - X	1. Ms. Nguyen Viet Linh 2. Mr. Nguyen Quang Minh	1. Investment & Growth Specialist 2. Autopilot Engineer
7	VMO HOLDINGS TECHNOLOGY JSC	1. Ms. Ruby Dang 2. Ms. Annie Vuong	1. Head of International Cooperation 2. Business Consultant
8	MAJ AGRICULTURAL SERVICES JSC	1. Mr. Le Thien Ngoc 2. Mr. Pham Phu Thinh	1. CEO 2. Vice Director
9	VCONNEX	Mr. Mai Xuan Hoang	Manager
10	CMC GLOBAL	Ms. Cao Le Yen Chi	Partnership Manager - Korea Market
11	AVATECH	1. Mr. Doan Nam Thai 2. Ms. Nguyen Xuyen	1. Director 2. Deputy Director / Business Development
12	CMC TELECOM	Mr. Lam Duc Manh	Account Manager
13	PROTECH	Mr. Le Hoai Trung	CEO

○ 전문 통역 지원

- 11.21(목) ~ 22(금) 양일간 동일 통역원 배치
- 사전 담당 기업의 제품 숙지 준비

번호	회사명	담당 통역원
1	넥스트칩(Nextchip)	Nguyen Thu Phuong
2	딥엑스(DeepX)	Trinh Thi Tuyet Mai
3	모빌린트(Mobilint)	Vu Thanh Hai
4	하이퍼엑셀(HyperAccel)	Do Thi Hai Yen

매칭테이블

	2024.11.21.(목)				2024.11.22.(금)			
No.	1	2	3	4	1	2	3	4
기업명	딥엑스 DeepX	넥스트칩 Nextchip	모빌린트 Mobilint	하이퍼엑셀 HyperAccel	딥엑스 DeepX	넥스트칩 Nextchip	모빌린트 Mobilint	하이퍼엑셀 HyperAccel
09:00 – 10:00 (11:00 – 12:00 KST)		9:10 BKAV CORPORAT ION		09:00 MES HI-TECH COMPANY LIMITED			10:00 MAJ AGRICULT URAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY	
10:00 – 11:00 (12:00 – 13:00 KST)	10:35 VNROBOTI CS	10:10 VNT STI-VIETN AM	09:35 MES HI-TECH COMPANY LIMITED			10:10 VNT AVATECH	10:30 AVATECH	09:45 CMC TELECOM
11:00 – 12:00 (13:00 – 14:00 KST)	10:10 MES HI-TECH COMPANY LIMITED		11:00 VNROBOTI CS		MAJ AGRICULT URAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY		11:20 CMC TELECOM	PROTECH (MoU)
Lunch Time								
13:00 – 14:00 (15:00 – 16:00 KST)		13:10 VNT CMC ATI		13:10 VNT PHENIKAA – X				
14:00 – 15:00 (16:00 – 17:00 KST)	13:35 PHENIKAA – X	14:00 PHENIKAA – X	14:50 PHENIKAA – X					
15:00 – 16:00 (17:00 – 18:00 KST)	CMC ATI		CMC ATI	VMO HOLDINGS TECHNOLO GY JOINT STOCK COMPANY				
16:00 – 17:00 (18:00 – 19:00 KST)				14:40 CMC ATI				

나. 참가기업 전시 결과

○ 기업별 지원 실적(수출상담)

- 넥스트칩: USD 11,100,000 (총 5회 수출상담)
- 덤엑스 : USD 550,000 (총 7회 수출상담)
- 모빌린트 : USD 219,460,000 (총 7회 수출상담)
- 하이퍼엑셀 : USD 1,120,000 (총 6회 수출상담)

○ 일자별 기업 수출 상담 실적

구분	11/21(목)			11/22(금)			총 계		
	상담 건수	상담액 (USD)	계약추진액 (USD)	상담 건수	상담액 (USD)	계약추진액 (USD)	상담 건수	상담액 (USD)	계약추진액 (USD)
넥스트칩	4	10,600,000	-	1	500,000	-	5	11,100,000	-
딥엑스	4	550,000	-	3	-	-	7	550,000	-
모빌린트	4	3,130,000	1,020,000	3	216,330,000	72,110,000	7	219,460,000	73,130,000
하이퍼엑셀	4	720,000	240,000	2	400,000	120,000	6	1,120,000	360,000
총계	16	14,650,000	1,260,000	9	217,230,000	72,230,000	25	232,230,000	73,490,000

상담일지 사례

[illegible]

2024 Korea-Vietnam Digital(DX) Forum Meeting Record			
* 동 자료는 귀사의 상담 후속 지원을 위한 소중한 자료로 활용되오니 다소 불편하시더라도 상세히 주시기 바랍니다.			
국내기업명 (Korean Company)	MOBILINT	상담자 (KOR)	Kim Seungmo
상담목적 (Products)	AI OGP	통역원 (Interpreter)	김민하
상담일시	2024/11/22		단위: 달러, USD
바이어회사명 (Company)	AWATECH	바이어명 (Buyer)	Mr. Loan Nam Tran
상담액	계약추진액	바이어 명함 또는 정보상장 화면 등	
당초 ***	금 10,000	- Director - 84563 7337 OGP - mdoan_aua@gmail.com	
현장계약액 (Contract Amount on the spot)			
상담내용(바이어명, 계약상장 등)			
- 바이어인 AWATECH는 AI 기반의 IoT 분야 기업 - 현재는 제품 개발 단계에 있음 - 현재는 2개년 분할 계약으로 진행 중임 - 현재는 2개년 분할 계약으로 진행 중임 - 현재는 2개년 분할 계약으로 진행 중임 - 현재는 2개년 분할 계약으로 진행 중임 - 현재는 2개년 분할 계약으로 진행 중임			
작성해 주셔서 감사합니다.			
1) 상담 액: 3 년 이내 계약 가능 계약 금액 (Estimated Contract Amount in three years) 2) 계약추진액: 1 년 이내 계약 가능 계약 금액 (Estimated Contract Amount in a year) 3) 현장계약액: 상담하는 현장에서 계약이 체결된 경우의 현장 계약 금액 (Contract Amount on the spot)			

Hyper Axel (2024/11/22)			
2024 Korea-Vietnam Digital(DX) Forum Meeting Record			
* 동 자료는 귀사의 상담 후속 지원을 위한 소중한 자료로 활용되오니 다소 불편하시더라도 상세히 주시기 바랍니다.			
국내기업명 (Korean Company)	Hyper Axel	상담자 (KOR)	정영민
상담목적 (Products)	LEDs, LPU	통역원 (Interpreter)	Nguyen Thi Hong Nhung
상담일시	2024/11/22		단위: 달러, USD
바이어회사명 (Company)	proTech	바이어명 (Buyer)	Mr. Loan Nam Tran
상담액	계약추진액	바이어 명함 또는 정보상장 화면 등	
당초 ***	금 10,000	- Director - 84563 7337 OGP - mdoan_aua@gmail.com	
현장계약액 (Contract Amount on the spot)			
상담내용(바이어명, 계약상장 등)			
- 바이어인 proTech는 LED 분야 기업 - 현재는 제품 개발 단계에 있음 - 현재는 2개년 분할 계약으로 진행 중임 - 현재는 2개년 분할 계약으로 진행 중임 - 현재는 2개년 분할 계약으로 진행 중임 - 현재는 2개년 분할 계약으로 진행 중임 - 현재는 2개년 분할 계약으로 진행 중임			
작성해 주셔서 감사합니다.			
1) 상담 액: 3 년 이내 계약 가능 계약 금액 (Estimated Contract Amount in three years) 2) 계약추진액: 1 년 이내 계약 가능 계약 금액 (Estimated Contract Amount in a year) 3) 현장계약액: 상담하는 현장에서 계약이 체결된 경우의 현장 계약 금액 (Contract Amount on the spot)			

모빌린트

하이퍼엑셀

○ 상담 목록

날짜	한국기업	베트남 바이어사	상담액	계약추진액
11/21(목)	딥엑스	VNROBOTICS	\$ 150,000	-
11/21(목)	딥엑스	MES HI-TECH COMPANY LIMITED	\$ 100,000	-
11/21(목)	딥엑스	PHENIKAA - X	\$ 100,000	-
11/21(목)	딥엑스	CMC ATI	\$ 200,000	-
11/21(목)	넥스트칩	BKAV CORPORATION	\$ 1,750,000	-
11/21(목)	넥스트칩	STI-VIETNAM	\$ 350,000	-
11/21(목)	넥스트칩	CMC ATI	\$ 3,500,000	-
11/21(목)	넥스트칩	PHENIKAA - X	\$ 5,000,000	-
11/21(목)	모빌린트	MES HI-TECH COMPANY LIMITED	\$ 30,000	\$ 10,000
11/21(목)	모빌린트	VNROBOTICS	-	-
11/21(목)	모빌린트	PHENIKAA - X	\$ 100,000	\$ 10,000
11/21(목)	모빌린트	CMC ATI	\$ 3,000,000	\$ 1,000,000
11/21(목)	하이퍼엑셀	MES HI-TECH COMPANY LIMITED	\$ 180,000	\$ 60,000
11/21(목)	하이퍼엑셀	PHENIKAA - X	\$ 180,000	\$ 60,000
11/21(목)	하이퍼엑셀	VMO HOLDINGS TECHNOLOGY	\$ 180,000	\$ 60,000

		JOINT STOCK COMPANY		
11/21(목)	하이퍼엑셀	CMC ATI	\$ 180,000	\$ 60,000
11/22(금)	딥엑스	MAJ AGRICULTURAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY	-	-
11/22(금)	딥엑스	VCONNEX	-	-
11/22(금)	딥엑스	CMC GLOBAL	-	-
11/22(금)	넥스트칩	AVATECH	\$ 500,000	-
11/22(금)	모빌린트	MAJ AGRICULTURAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY	\$216,000,000	\$ 72,000,000
11/22(금)	모빌린트	AVATECH	\$ 30,000	\$ 10,000
11/22(금)	모빌린트	CMC TELECOM	\$ 300,000	\$ 100,000
11/22(금)	하이퍼엑셀	CMC TELECOM	\$ 200,000	\$ 60,000
11/22(금)	하이퍼엑셀	PROTECH	\$ 200,000	\$ 60,000

○ MOU 체결

- 11월 22일(금) 하이퍼엑셀과 PROTECH 사 MOU 체결 완료

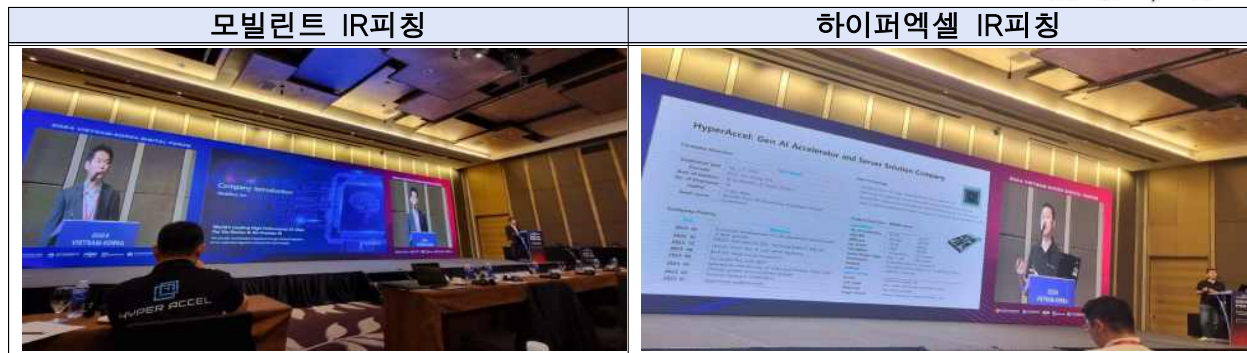
한국기업	베트남 바이어사	MOU
하이퍼엑셀	PROTECH	PROTECH : Mr. Le Hoai Trung (CEO) HYPERACCEL : Mr. JungYongWoong(CSO)



하이퍼엑셀 - PROTECH

○ AI반도체 IR피칭 발표

- 모빌린트 : World 's Leading High Performance AI Chips for On-Device & On-Premise AI (김성모 상무)
- 하이퍼엑셀 : AI Semiconductor for LLM (정용웅 CSO)



○ 뉴스 인터뷰 취재 및 중계

- 반도체AI기업 뉴스 중계 송출 및 통역 지원
- 모빌린트, 하이퍼엑셀 인터뷰 진행

* URL

- <https://vnews.gov.vn/video/ban-tin-thoi-su-21h-ngay-21-11-2024-142596.htm>
- <https://www.facebook.com/share/v/17AAsSamu4/>

<인터뷰 현장>



<방영 내용>



: <https://www.facebook.com/vnews.gov.vn/>; Youtube.com/vnewstruyenhinhthongtan TRAN TRUNG

다. 전시 운영 결과

(1) ‘한-베트남 디지털 포럼’ 전시부스 운영

- 동남아 해외시장 초기 수요 발굴을 목적으로 한 전시로서, 사전 국내외 보도자료 배포 및 현장 홍보 활성화를 위한 전략 도입
- 매체 홍보, 카달로그 배포 등 홍보 수립
- 국내 AI반도체 기업 제품 전시 및 데모 시연 지원

(2) 참가기업 비즈매칭 활성화

- 사전 기업별 매칭표 전달 및 비즈매칭 통역 지원
- 당일 현장매칭으로 진행된 상담 및 비즈매칭 상담일지 관리
- 전시 이후, 후속 성과조사로 인한 상담액 및 계약예상액 추정

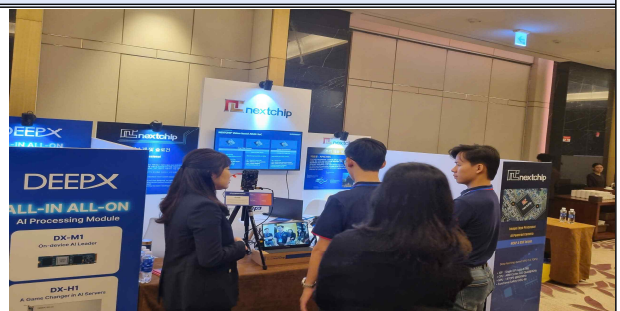
(3) 베트남 현지 수요 업체와의 네트워킹 지원

- 베트남 현지 기업 수요처와 연계하여 AI반도체 시장 정보 수집 및 협력 네트워크 확보
- 하노이IT지원센터와 협력하여 현지 AI반도체 현황 및 주요 수요처 정보 확보

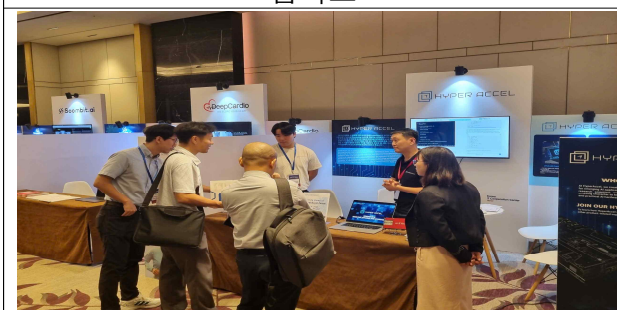
전시 현장 결과



딥엑스



넥스트칩



하이퍼엑셀



모빌린트

□ 세부 일정

일 정		내 용	비 고
11.20(수)	18:40-21:40	• 이동(한국 인천→베트남 하노이)	KE0453
11.21(목)	09:00-20:00	<ul style="list-style-type: none"> • 개막식 및 기조연설, 우수사례 발표 • ‘한-베 DX포럼’ 전시지원 • 제품 홍보 운영 및 비즈니스 미팅지원 • 한-베 초청기업 네트워킹 행사 	
11.22(금)	09:00-18:00	<ul style="list-style-type: none"> • ‘한-베 DX포럼’ 전시지원 • 제품 홍보 운영 및 비즈니스 미팅지원 • 시장정보수집, 협력네트워크 미팅 • AI반도체 기업 IR피칭 	
11.23(토)	12:20~18:25	• 이동(베트남 하노이→한국 인천)	KE0442